

公平交易委員會（下稱公平會）與 Qualcomm Incorporated（下稱美商高通公司）於智慧財產法院合議庭（下稱智財法院）試行和解下，就公平會106年10月20日公處字第106094號處分有關專利權行使爭議案（下稱原處分），依法達成訴訟上和解。

依據和解內容，美商高通公司對國內手機製造商及晶片供應商作出行為承諾，並負有向公平會報告執行情形之義務；美商高通公司同意不爭執已繳納之新臺幣（下同）27億3千萬元罰鍰，並承諾在臺灣進行為期5年之產業投資方案，說明如下：

一、公平會表示，美商高通公司同意遵守並執行授權行動通訊標準必要專利（下稱行動通訊 SEP）予臺灣手機製造商之行為承諾及若美商高通公司擬將行動通訊 SEP 授權予臺灣晶片供應商時之其他行為承諾，已足以消解原處分對美商高通公司行動通訊 SEP 授權實務之反競爭疑慮：

1、本於善意重新協商授權條款：

臺灣手機授權製造商如認為其與美商高通公司之專利授權合約中有被迫同意且不合理之授權條款，美商高通公司承諾將本於善意重新協商，就重新協商條款之爭議，臺灣手機授權製造商與美商高通公司可另行協議採取其他如法院或仲裁之中立爭端解決程序。

2、協商期間不拒絕晶片供應：

在重新協商或爭端解決程序期間，臺灣手機授權製造商如繼續履行其供應及授權合約義務，並本於善意進

行重新協商，美商高通公司同意其不會終止或威脅終止供應行動數據機晶片予該製造商。

3、行動通訊 SEP 授權之無歧視性待遇：

美商高通公司承諾就其行動通訊 SEP 授權方案，將對條件相當之臺灣手機製造商與非臺灣手機製造商給予無歧視之待遇。

4、對臺灣晶片供應商之待遇：

美商高通公司同意，經臺灣晶片供應商要求，其將提供一合約。該合約約定，如美商高通公司未先就行動通訊 SEP 請求項向晶片供應商提出依公平、合理且無歧視（FRAND）之授權條款，美商高通公司不得本於任何行動通訊 SEP 請求項對該晶片供應商提起任何訴訟。

5、不再簽署獨家交易之折讓約定：

美商高通公司承諾，在其與晶片客戶之晶片供應合約中，不再簽署任何以客戶同意獨家採用美商高通公司行動數據機晶片為條件，而給予權利金折讓之約定；及不再以該晶片客戶之全部晶片採購有一定比率係向美商高通公司採購，作為契約之授權金折扣或權利金折讓約定之條件。

6、定期向公平會報告執行情形：

美商高通公司並承諾在 5 年期間內，每 6 個月就行為承諾之執行情形向公平會進行報告，如美商高通公司與臺灣手機製造商或臺灣晶片供應商完成增修或新訂契約，亦將於簽署該等契約後 30 日內向公平會進行報告。

公平會指出，原處分要求美商高通公司在處分後應本於

善意及誠信對等原則與晶片競爭同業及手機製造商進行協商，並停止反競爭疑慮之行為，而美商高通公司在訴訟上和解除所提出之行為承諾，公平會認為足以達到原處分維護自由公平競爭之規制目的。

二、公平會表示，原處分所裁處之 234 億元罰鍰，美商高通公司同意不爭執已分期繳納共計 27 億 3 千萬元之罰鍰，並承諾以 5 年期產業方案對臺灣進行投資合作，該投資包含 5G 合作、新市場拓展、與新創公司及大學之合作，並設立臺灣營運及製造工程中心。高通公司將與公平會及臺灣經濟部、科技部等相關單位緊密配合，以落實上述方案及投資。公平會認為該產業投資方案及其承諾之投入，將有助於提升臺灣半導體、行動通訊及 5G 技術發展等方面之整體經濟利益與公共利益。

因此，本案經綜合審酌後，公平會於 107 年 8 月 8 日第 1396 次委員會議決議通過，並於 107 年 8 月 9 日在智財法院與美商高通公司達成公平會史上首次基於公共利益之訴訟上和解除，原處分以和解內容代替之。公平會希望本案能有效地形塑行動通訊產業良好之競爭環境，並對臺灣半導體、行動通訊及 5G 技術發展等各方面帶來正面影響。